2027年3月期 第2四半期 決算説明資料

2026年11月9日

JX金属株式会社

目次

1 ハイライト

2 2026年度（2027年3月期） 上期実績

3 2026年度（2027年3月期） 通期見通し

4 Appendix

Copyright © 2026, JX Advanced Metals Corporation, All rights reserved.

ハイライト

Copyright © 2026, JX Advanced Metals Corporation, All rights reserved.

ハイライト - 2026年度 上期実績･2026年度 通期見通し

営業損益 フォーカス事業、半導体材料セグメントは継続的な需要拡大により、アナリスト予想平均値*を上回る利益水準を見込む

2026年度 上期実績

前年同期	当年実績	差異
700 億円	**1,508** 億円	**＋808** 億円
為替 146 円/USD 銅価 438 ¢/lb	為替 159 円/USD 銅価 622 ¢/lb	為替 13 円/USD 円安 銅価 ＋184 ¢/lb

＋808 億円 差異要因

外部環境･一過性要因		事業要因	
●環境要因(市況)	＋585億円	●フォーカス事業 増販	＋170億円
●一過性要因	＋190億円	●フォーカス事業 販売単価改善	＋20億円
(カセロネス一部権益売却益)		●鉱山コスト等	▲85億円
●鉱山減産(チリ天候不良)	▲70億円		

2026年度 通期見通し

10月以降銅価が650 ¢/lbで推移した場合
2,550億円 ▶ **2,650億円程度**となる見込み

8月公表	11月公表	差異
2,320 億円	**2,550** 億円	**＋230** 億円
為替 157 円/USD 銅価 586 ¢/lb	為替 157 円/USD 銅価 619 ¢/lb**	為替 8月公表並み 銅価 ＋33 ¢/lb

＋230 億円 差異要因

外部環境･一過性要因		事業要因	
●環境要因(市況)	＋195億円	●フォーカス事業 増販	＋40億円
		●フォーカス事業 販売単価改善	＋60億円
		●ベース事業 減産	▲145億円
		●ベース事業 マージン・コスト差等	＋80億円

** 10月以降前提 615 ¢/lb
(参考)10月実績平均銅価 659 ¢/lb

通期業績推移

営業損益	2024年度 実績	2025年度 実績	2026年度見通し (8月公表)	**2026年度見通し (11月公表)**	**YoY 成長率**	アナリスト予想 平均値*
全社	1,125 億円	1,750 億円	2,320 億円	2,550 億円	46%	2,650 億円
フォーカス事業	**518 億円**	**710 億円**	**1,000 億円**	**1,140 億円**	**61%**	1,050 億円
半導体材料セグメント	**267 億円**	**395 億円**	**610 億円**	**730 億円**	**85%**	640 億円

全社業績見通しのアナリスト予想平均値との差異は、ベース事業における減産影響(▲145億円)が主因

*2026年11月9日現在、当社が入手可能な最新アナリストレポートに記載された2026年度業績予想値を単純平均した集計値

Copyright © 2026, JX Advanced Metals Corporation, All rights reserved.

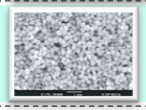
ハイライト - 主な製品 販売数量 増減率

			2026年度 上期実績 (2025年度 上期実績▶ 2026年度 上期実績)		2026年度 通期見通し (2025年度 通期実績 ▶ 2026年度 通期見通し)		
					8月公表	11月公表	
半導体材料	薄膜材料	半導体用ターゲット	+27%	AIデータセンター関連の需要拡大を取り込み、成長継続	+21%	⇗ +24%	半導体用ターゲット、磁性材ターゲットは上方修正 InP基板は、既存設備における生産効率改善を継続中
		磁性材ターゲット	+12%		+8%	⇗ +11%	
		インジウムリン InP基板	+11%		+13%	⇨ +13%	
	TaNb*	キャパシタ向けタンタル粉末	+19%		+2% AIデータセンター +62% その他 ▲9%	⇨ +2% AIデータセンター +62% その他 ▲9%	8月公表並み
		*TaNb：タンタル・ニオブ					
情報通信材料	機能材料	圧延銅箔	+11%	スマートフォン関連の堅調な需要を背景に増販	+5%	⇨ +5%	8月公表並み
		チタン銅	+30%	AIデータセンター関連の需要拡大を取り込み、成長継続	+33%	⇨ +33%	

Copyright © 2026, JX Advanced Metals Corporation, All rights reserved.

ハイライト – 生産能力増強計画

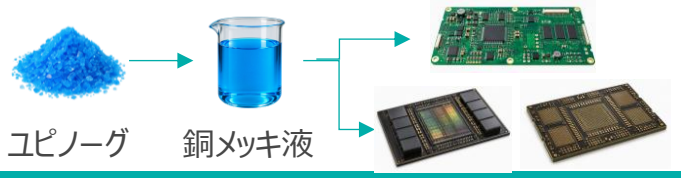
✓ AIデータセンター関連を中心とした需要拡大に対応するため、引き続き生産能力の増強を推進　　2Qアップデート

事業セグメント		製品		増産規模（生産能力・2025年度比）	増産時期	増産の背景
半導体材料	薄膜材料	半導体用ターゲット		1.3倍	2027年度から順次	AIデータセンター向け最先端ロジック・HBM等の需要増
		磁性材ターゲット		1.2倍 ▶ 1.5倍	2026年度下期　1.2倍 2029年半ば　1.5倍	AIデータセンター需要拡大に伴うHDメディア需要増
		InP基板		7～10倍	2026年度下期から順次	AIデータセンターの需要拡大、サーバー内での光通信の適用範囲の拡大
		ユピノーグ		1.5倍	2027年度下期から順次	先端パッケージングやHBM向けの銅めっき材料の急激な需要増
	タンタル・ニオブ	タンタル粉末		1.5倍	2027年前半から順次	半導体製造向けスパッタリングターゲット・AIデータセンター向けキャパシタの需要増
情報通信材料	機能材料	チタン銅		1.5倍	2029年度	AIデータセンター向けコネクタの需要増
	東邦チタニウム	MLCC用 超微粉Ni		(小粒径品) 2倍	2027年度上期	AIデータセンター向けMLCCの需要増
	タツタ	漏水センサ		1.3倍 ▶ 4倍	2026年8月 1.3倍 2027年9月 4倍	AIサーバーの発熱量増に伴う水冷の需要増

ユピノーグ (高純度硫酸銅)

✓ 主な用途は、**半導体・パッケージ基板・プリント基板**の製造時に用いられる**銅メッキ液**の原料

✓ 用途先は、従来のプリント基板に加え、**AI向けの半導体・パッケージ基板向け需要が拡大**



Copyright © 2026, JX Advanced Metals Corporation, All rights reserved.

ハイライト – サプライチェーン強化

フォーカス事業に必要な原料のサプライチェーン強化に向け、ベース事業での出資や共同スタディ等の取り組みを継続

フォーカス事業

磯原工場



ひたちなか工場



磯原工場で扱う元素

56 種類

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	H																	He
2	Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
3	Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
4	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
5	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
6	Cs	Ba	※1	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
7	Fr	Ra	※2	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	Fl	Mc	Lv	Ts	Og
※1 ランタノイド系	La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu			
※2 アクチノイド系	Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr			

※()内は対象元素とリリース年度

2Qでのリリース

【金属・リサイクル】E-waste回収・処理事業者 eCycle Solutions社の株式取得 (2022年度)

- **概要:** レアアース精鉱・元素の分離・浸出・精製についての事業性を共同評価。レアアースのサプライチェーンにおける特定地域への依存低減を目指す
  ※Tronox社: 鉱物採掘～製品生産を一貫で手掛ける世界最大級の米国酸化チタン顔料メーカー
- **費用:** 32百万USD (50%ずつ負担予定)

【金属・リサイクル】国内資源循環の高度化を目指した、リネットジャパングループとの資本業務提携 (2026年度)

【資源】【金属・リサイクル】レアアース製錬事業への新規参入に向けたTronox社との共同スタディ (La, Nd, Sm, Ho, Er, Tm, Yb, Y; 2026年度)

【資源】Copi PJ(豪州ミネラルサンド鉱床開発)への参画 (ジルコン・モナザイト・イルメナイト・ルチル等; 2025年度)

【資源】レアメタル探査・開発を行うFireweed Metals社への出資 (W, Ga, Ge; 2025年度)

【資源】Mibra鉱山におけるタンタル原料生産事業への参画 (Ta; 2022年度)

※Ta: タンタル, W: タングステン, Ga: ガリウム, Ge: ゲルマニウム, La: ランタン, Nd: ネオジム, Sm: サマリウム, Ho: ホルミウム, Er: エルビウム, Tm: ツリウム, Yb: イッテルビウム, Y: イットリウム
※ジルコン, モナザイト, イルメナイト, ルチルは鉱物

Copyright © 2026, JX Advanced Metals Corporation, All rights reserved.

ハイライト – 関連領域における上場企業との業務・資本提携

半導体材料

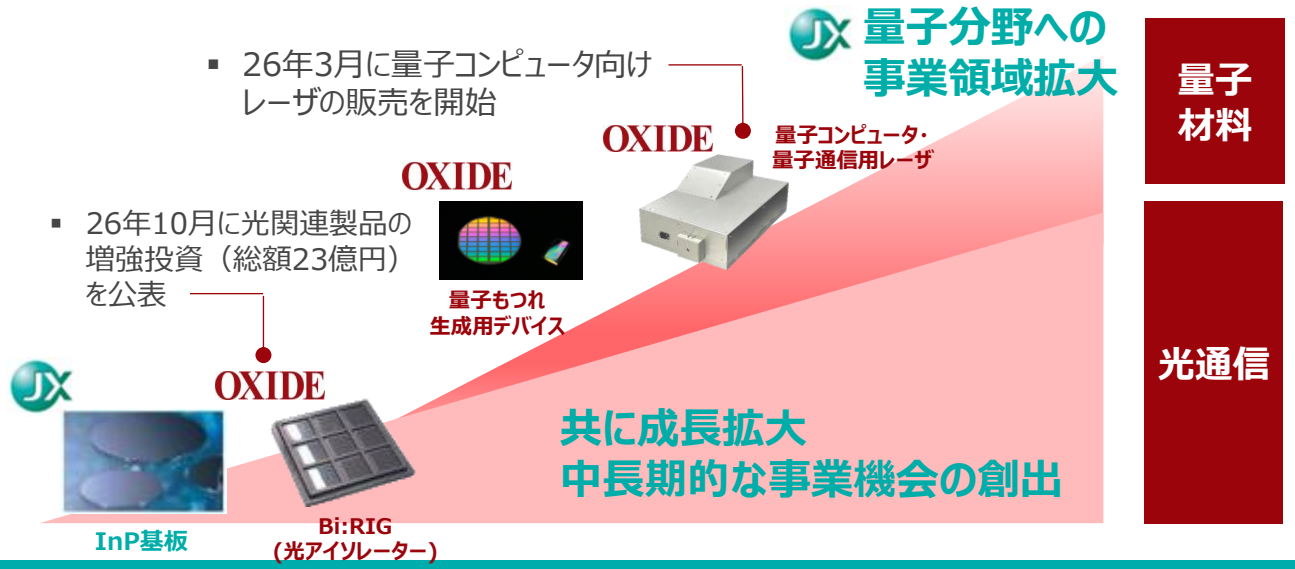
**フォトニクス分野のリーディングカンパニーである
オキサイド社との資本業務提携契約**

AIデータセンター向け光部材と量子分野において事業を拡大するオキサイド社との資本提携により、当社結晶材料事業の光・量子分野の材料を拡充

- 出資額/スキーム: 27.5億円/第三者割当増資
- 出資比率：7.12%

OXIDE
フォトニクス分野のリーディングカンパニー

- 光関連製品の需要が急増。材料は当社と**補完関係**にあり、**同じ領域で成長を目指す**
- **量子分野**において**幅広い技術を保有**



基礎材料

**JX金属サーキュラーソリューションズ（以下、JXCS）による
リネットジャパングループ社との業務・資本提携**

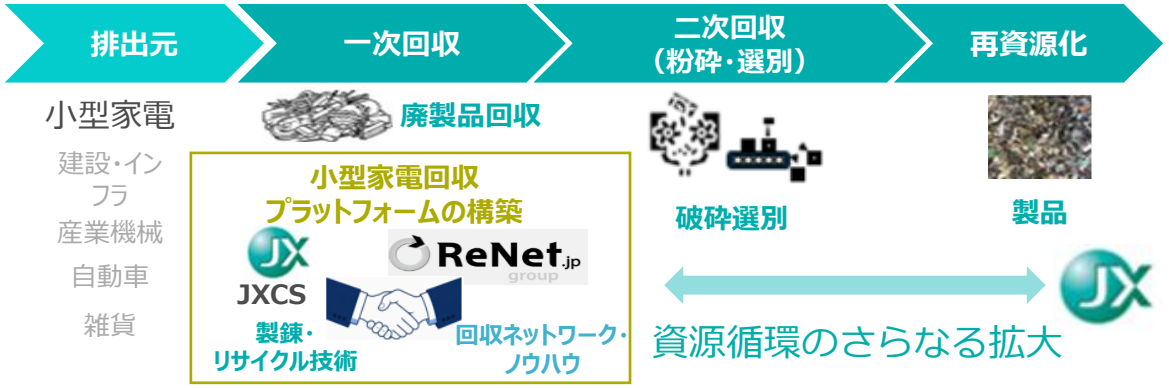
**両者の強みを生かした連携を進め、
国内資源循環の更なる高度化を目指す**

- 出資額/スキーム: 3.5億円/第三者割当増資
- 出資比率：2.4%

ReNet.jp group
強固な回収ネットワーク

- 京都市、横浜市といった大規模都市をはじめとして、**全国770以上の自治体と連携協定等を締結**
- **大手家電量販店やEコマースの回収プラットフォーム**として活用されている

✓ リサイクルサプライチェーンと提携によるシナジー



Copyright © 2026, JX Advanced Metals Corporation, All rights reserved.

2026年度（2027年3月期）　上期実績

Copyright © 2026, JX Advanced Metals Corporation, All rights reserved.

連結損益計算書

(億円)		2025年度 上期実績	2026年度 上期実績	前年同期比 差異	前年同期比 増減率
売上高		**3,964**	**5,315**	**+ 1,351**	**+34%**
(フォーカス事業)		2,388	3,009	+ 621	+26%
(ベース事業)		1,610	2,504	+ 894	+56%
(その他)		▲ 34	▲ 198	▲ 164	-
営業損益		**700**	**1,508**	**+ 808**	**+115%**
(フォーカス事業)		343	622	+ 279	+81%
(ベース事業)		404	955	+ 551	+136%
(その他)		▲ 47	▲ 69	▲ 22	-
税引前利益		**678**	**1,461**	**+ 783**	**+115%**
当期利益		**515**	**1,143**	**+ 628**	**+122%**
親会社の所有者に帰属する当期利益		**429**	**979**	**+ 550**	**+128%**
為替(円/USD)		146	159	+ 13	+9%
LME銅価(¢/lb)	平均	438	622	+ 184	+42%
	前期末/当期末	439/467	552/657		

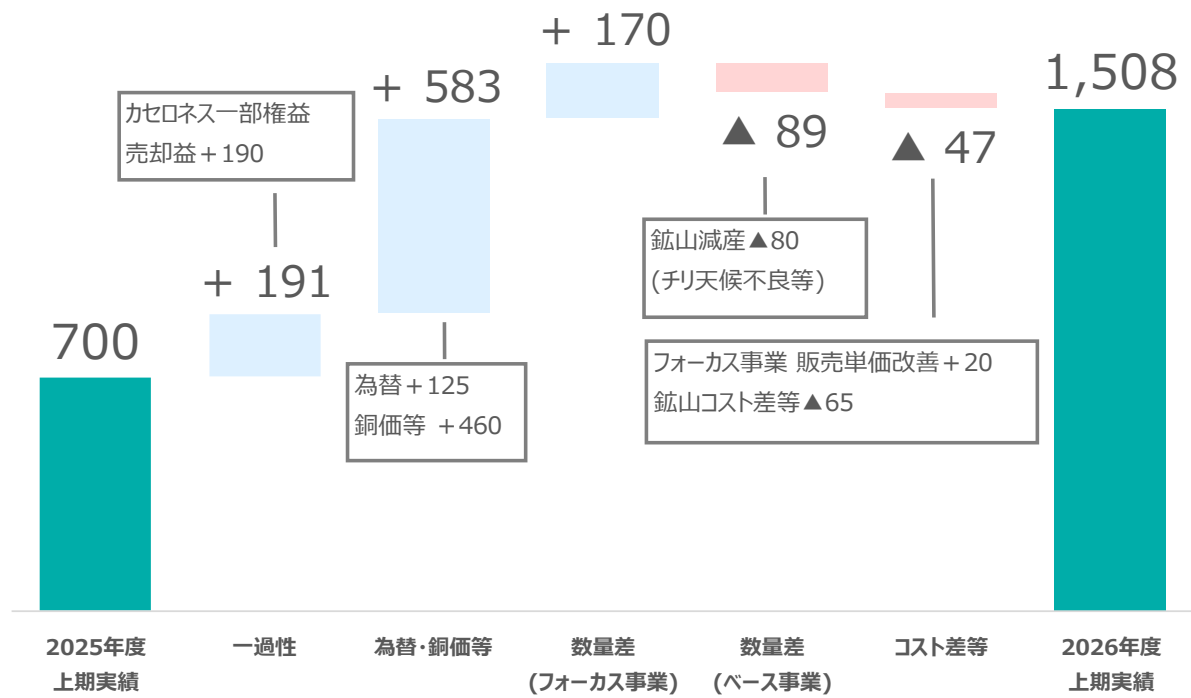
Copyright © 2026, JX Advanced Metals Corporation, All rights reserved.

事業セグメント別 売上高及び営業損益

		(億円)	2025年度 上期実績	2026年度 上期実績	前年同期比 差異	前年同期比 増減率
フォーカス事業	半導体材料	売上高	831	1,109	+ 278	+33%
		営業損益	190	361	+ 171	+90%
	情報通信材料	売上高	1,557	1,900	+ 343	+22%
		営業損益	153	261	+ 108	+71%
ベース事業	基礎材料	売上高	1,610	2,504	+ 894	+56%
		営業損益	404	955	+ 551	+136%
その他	事業共通費用等	売上高	▲ 34	▲ 198	▲ 164	-
		営業損益	▲ 47	▲ 69	▲ 22	-
合計		**売上高**	**3,964**	**5,315**	**+ 1,351**	**+34%**
		営業損益	**700**	**1,508**	**+ 808**	**+115%**

営業損益差異

(億円)

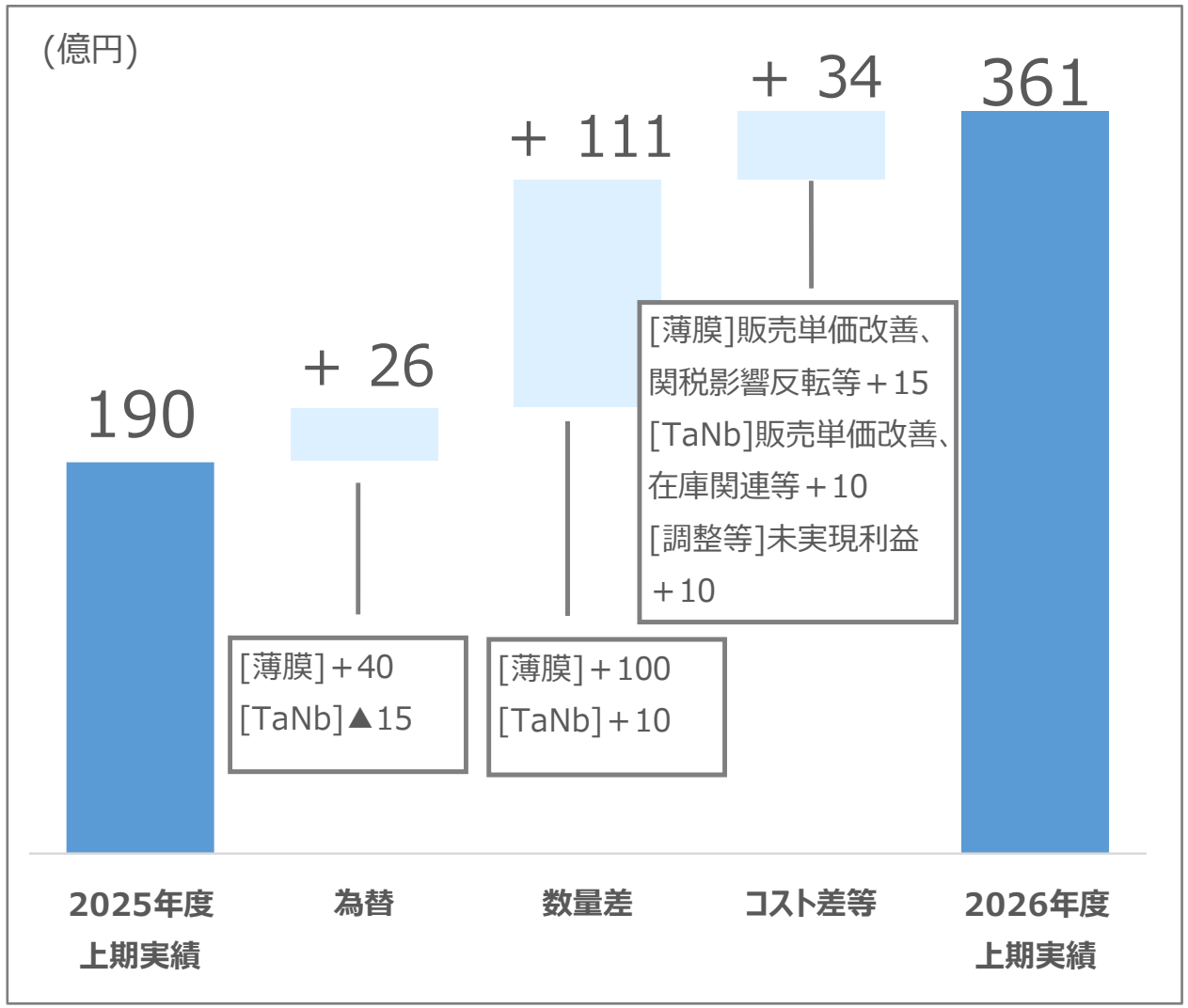


(内訳)	一過性	為替･銅価等	数量差 (フォーカス事業)	数量差 (ベース事業)	コスト差等	詳細記載ページ
半導体	−	+ 26	+ 111	−	+ 34	p.12
情報通信	−	+ 29	+ 59	−	+ 20	p.13
基礎	+ 191	+ 528	−	▲ 89	▲ 79	p.14
その他	−	−	−	−	▲ 22	

Copyright © 2026, JX Advanced Metals Corporation, All rights reserved.

営業損益差異分析　半導体材料セグメント[2026年度上期実績 対 2025年度上期実績]

営業損益差異分析



事業別概況

薄膜材料
- AIデータセンター関連需要の拡大を受けた主力製品の増販継続、販売単価改善等により増益

タンタル・ニオブ(TaNb)
- キャパシタ向けタンタル粉末増販、販売単価改善等により増益

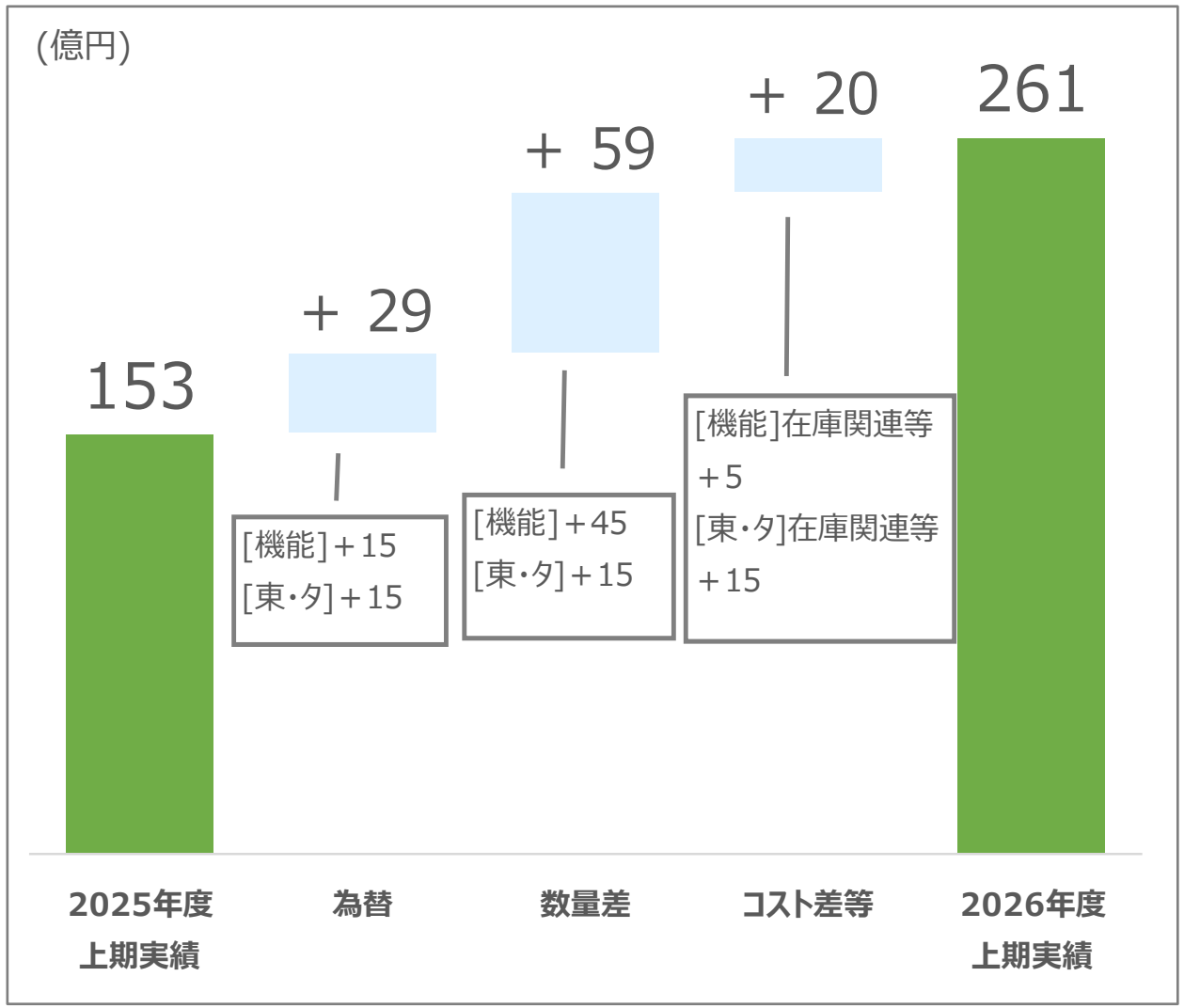
事業別 売上高・営業損益

	億円	2025年度 上期実績	2026年度 上期実績	前年同期比 差異	前年同期比 増減率
薄膜材料	売上高	674	935	+ 261	+39%
	営業損益	185	335	+ 150	+81%
タンタル・ニオブ(TaNb)	売上高	230	262	+ 32	+14%
	営業損益	10	21	+ 11	+110%
調整等	売上高	▲ 73	▲ 88	▲ 15	–
	営業損益	▲ 5	5	+ 10	–
セグメント合計	**売上高**	**831**	**1,109**	**+ 278**	**+33%**
	営業損益	**190**	**361**	**+ 171**	**+90%**

Copyright © 2026, JX Advanced Metals Corporation, All rights reserved.

営業損益差異分析　情報通信材料セグメント[2026年度上期実績 対 2025年度上期実績]

営業損益差異分析



事業別概況

機能材料

- 堅調なスマートフォン関連の需要や、AIデータセンター関連の需要拡大を背景とした増販、為替円安により増益

東邦チタニウム、タツタ電線等

- 為替円安、AIデータセンター関連製品(漏水センサ)の増販等により増益

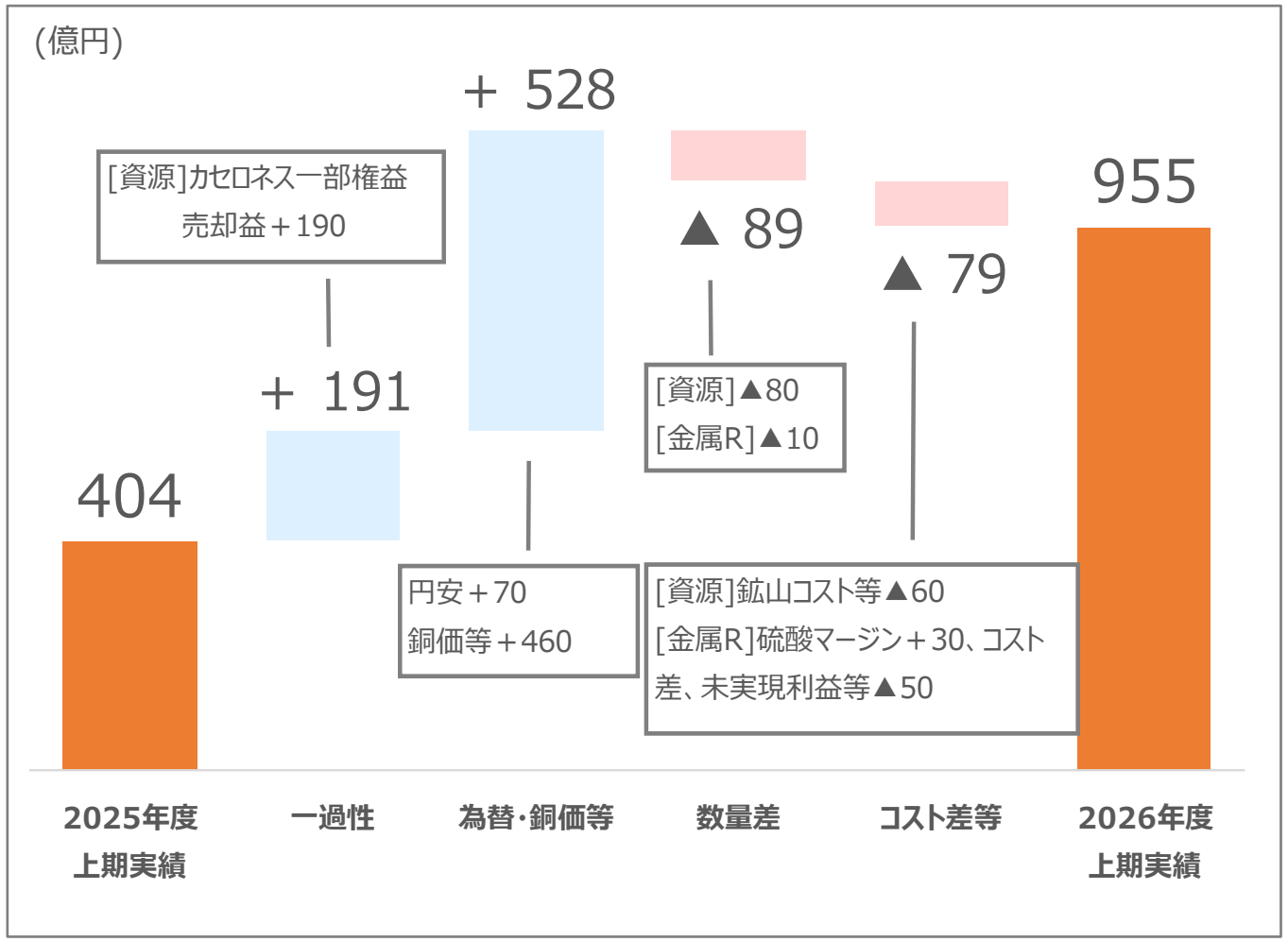
事業別 売上高･営業損益

	億円	2025年度 上期実績	2026年度 上期実績	前年同期比 差異	前年同期比 増減率
機能材料	売上高	784	994	+ 210	+27%
	営業損益	113	177	+ 64	+57%
東邦チタニウム、タツタ電線等	売上高	773	906	+ 133	+17%
	営業損益	40	84	+ 44	+110%
セグメント合計	**売上高**	**1,557**	**1,900**	**+ 343**	**+22%**
	営業損益	**153**	**261**	**+ 108**	**+71%**

Copyright © 2026, JX Advanced Metals Corporation, All rights reserved.

営業損益差異分析　基礎材料セグメント[2026年度上期実績 対 2025年度上期実績]

営業損益差異分析



事業別概況

資源

- チリ天候不良による鉱山における減産はあるものの、カセロネス権益一部譲渡に伴う売却益、為替円安・銅価等の上昇を主因に増益

金属･リサイクル（金属R）

- 為替円安、銅価等の上昇、硫酸マージン改善等により増益

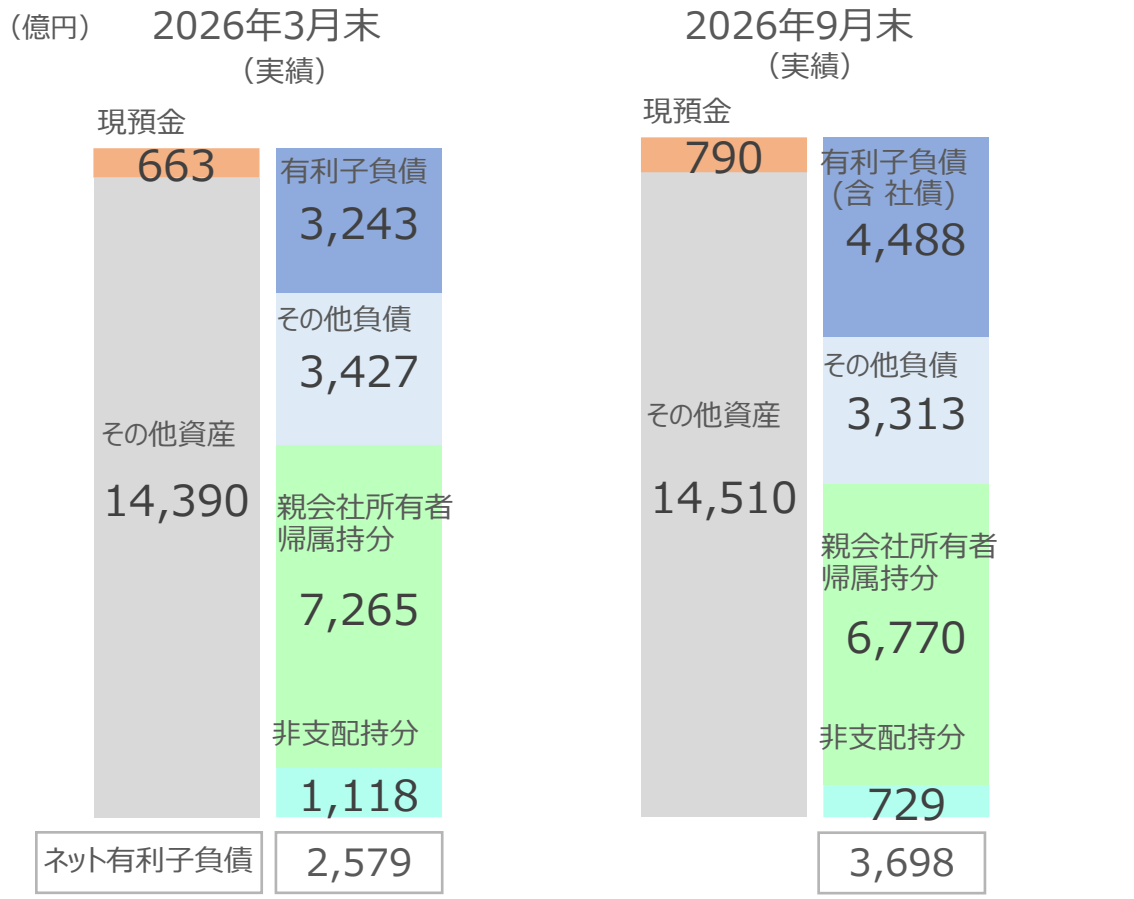
事業別 売上高･営業損益

	億円	2025年度 上期実績	2026年度 上期実績	前年同期比 差異	前年同期比 増減率
資源	売上高	17	24	＋ 7	+41%
	営業損益	266	729	＋ 463	+174%
金属･リサイクル（金属R）	売上高	1,595	2,481	＋ 886	+56%
	営業損益	141	232	＋ 91	+65%
調整等	売上高	▲ 2	▲ 1	＋ 1	－
	営業損益	▲ 3	▲ 6	▲ 3	－
セグメント合計	**売上高**	**1,610**	**2,504**	**＋ 894**	**+56%**
	営業損益	**404**	**955**	**＋ 551**	**+136%**

Copyright © 2026, JX Advanced Metals Corporation, All rights reserved.

連結バランスシート・キャッシュフロー/投融資・減価償却費・研究開発費

■ 連結バランスシート



CBの発行を主因として、有利子負債増加。他方、自己株式の取得により、自己資本の減少を通じ資本効率は改善

■ 連結キャッシュフロー

(億円)

	2026年度 上期実績
営業キャッシュフロー	818
投資キャッシュフロー	13
フリーキャッシュフロー	**831**
財務キャッシュフロー	▲ 704
現金同等物の増減額	**127**
為替変動による影響等	0

■ 投融資・減価償却費・研究開発費

(億円)	2024年度 実績	2025年度 実績	2026年度 上期実績
投融資	923	845	372
減価償却費	440	447	253
研究開発費	178	200	103

Copyright © 2026, JX Advanced Metals Corporation, All rights reserved.

2026年度（2027年3月期）　通期見通し

Copyright © 2026, JX Advanced Metals Corporation, All rights reserved.

連結損益計算書

(億円)		2026年度 8月公表	2026年度 11月公表	前回比 差異	前回比 増減率
売上高		**10,250**	**10,500**	**+ 250**	**+2%**
(フォーカス事業)		5,850	6,200	+ 350	+6%
(ベース事業)		4,700	4,750	+ 50	+1%
(その他)		▲ 300	▲ 450	▲ 150	-
営業損益		**2,320**	**2,550**	**+ 230**	**+10%**
(フォーカス事業)		1,000	1,140	+ 140	+14%
(ベース事業)		1,470	1,550	+ 80	+5%
(その他)		▲ 150	▲ 140	+ 10	-
税引前利益		**2,210**	**2,440**	**+ 230**	**+10%**
当期利益		**1,740**	**1,960**	**+ 220**	**+13%**
親会社の所有者に帰属する当期利益		**1,410**	**1,600**	**+ 190**	**+13%**
為替(円/USD)		157	157	–	-
LME銅価(¢/lb)	平均	586	619	+ 33	+6%
	前期末/当期末	552/580	552/600		

為替・LME銅価前提

	10月～12月	1月～3月
為替(円/USD)	155	
LME銅価(¢/lb)	630	600

営業利益感応度 (2026年10月以降)

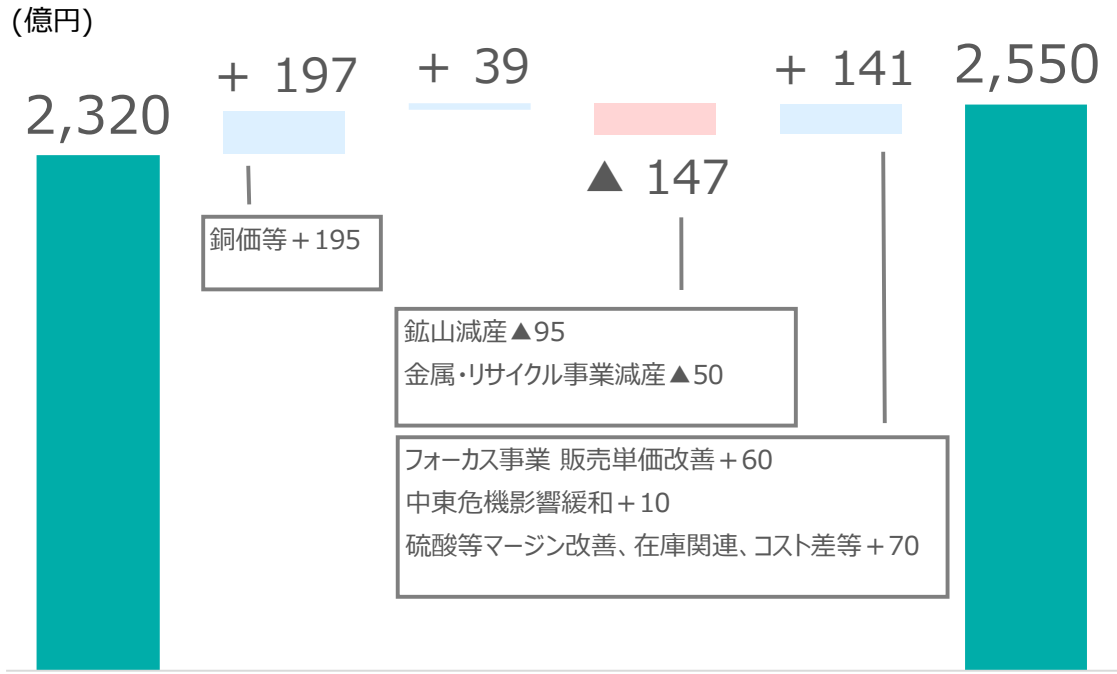
単位：億円	為替 5円円安	銅価 +10¢/lb
フォーカス事業	+25	–
ベース事業	+25	+25
合計	+50	+25

Copyright © 2026, JX Advanced Metals Corporation, All rights reserved.

事業セグメント別 売上高及び営業損益

		(億円)	2026年度 8月公表	2026年度 11月公表	前回比 差異	前回比 増減率
フォーカス事業	半導体材料	売上高	2,300	2,400	+ 100	+4%
		営業損益	610	730	+ 120	+20%
	情報通信材料	売上高	3,550	3,800	+ 250	+7%
		営業損益	390	410	+ 20	+5%
ベース事業	基礎材料	売上高	4,700	4,750	+ 50	+1%
		営業損益	1,470	1,550	+ 80	+5%
その他	事業共通費用等	売上高	▲ 300	▲ 450	▲ 150	-
		営業損益	▲ 150	▲ 140	+ 10	-
合計		**売上高**	**10,250**	**10,500**	**+ 250**	**+2%**
		営業損益	**2,320**	**2,550**	**+ 230**	**+10%**

営業損益差異

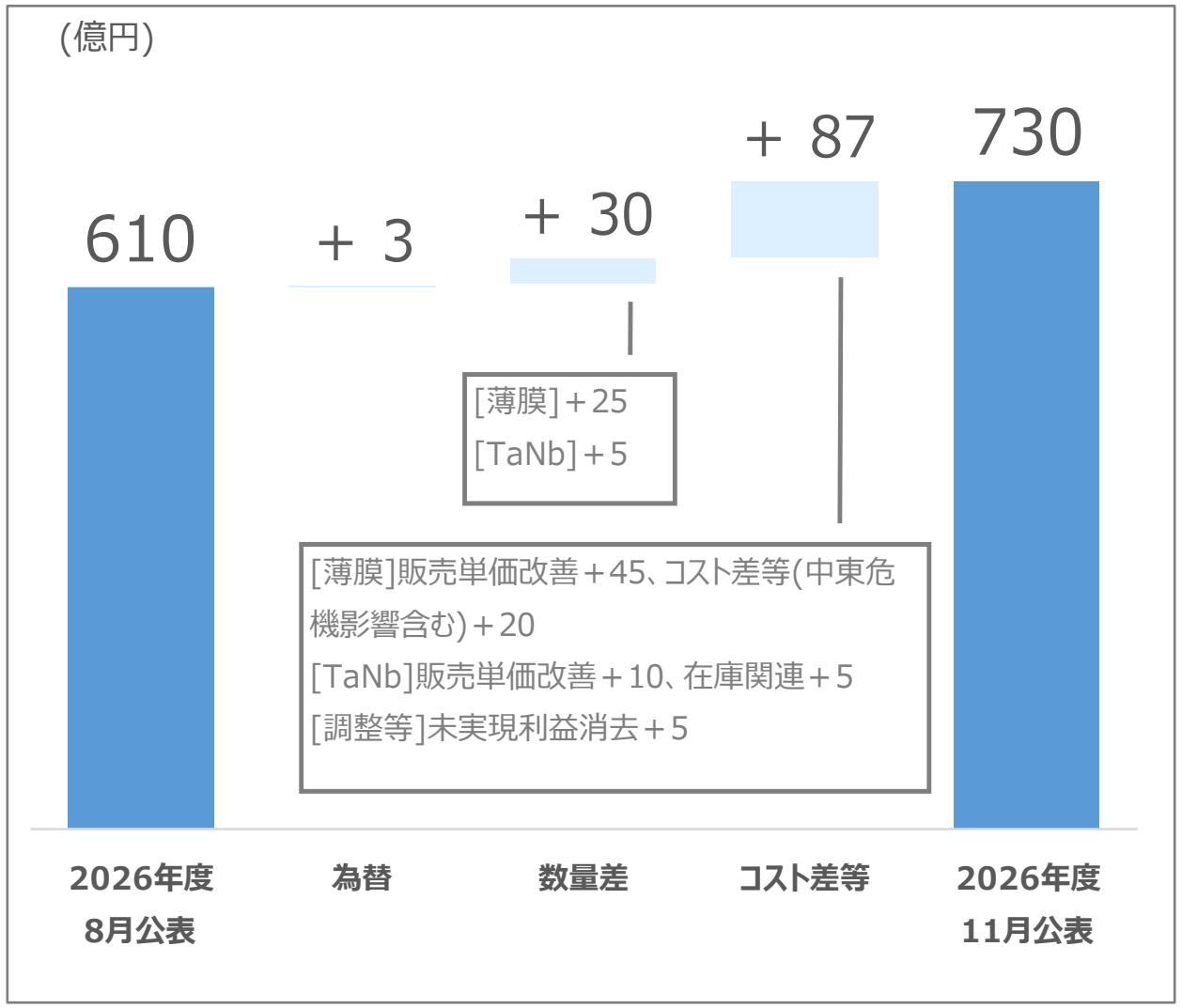


(内訳)	+ 197	+ 39	▲ 147	+ 141	詳細記載ページ
半導体	+ 3	+ 30	–	+ 87	p.19
情報通信	–	+ 9	–	+ 11	p.20
基礎	+ 194	–	▲ 147	+ 33	p.21
その他	–	–	–	+ 10	

Copyright © 2026, JX Advanced Metals Corporation, All rights reserved.

営業損益差異分析　半導体材料セグメント[2026年度見通し 11月公表 対 8月公表]

営業損益差異分析



事業別概況

薄膜材料

- AIデータセンター関連の需要拡大を受けた増販および半導体用ターゲット等の販売単価改善、中東危機影響緩和を主因に増益

タンタル・ニオブ(TaNb)

- 販売単価改善、在庫影響等により増益

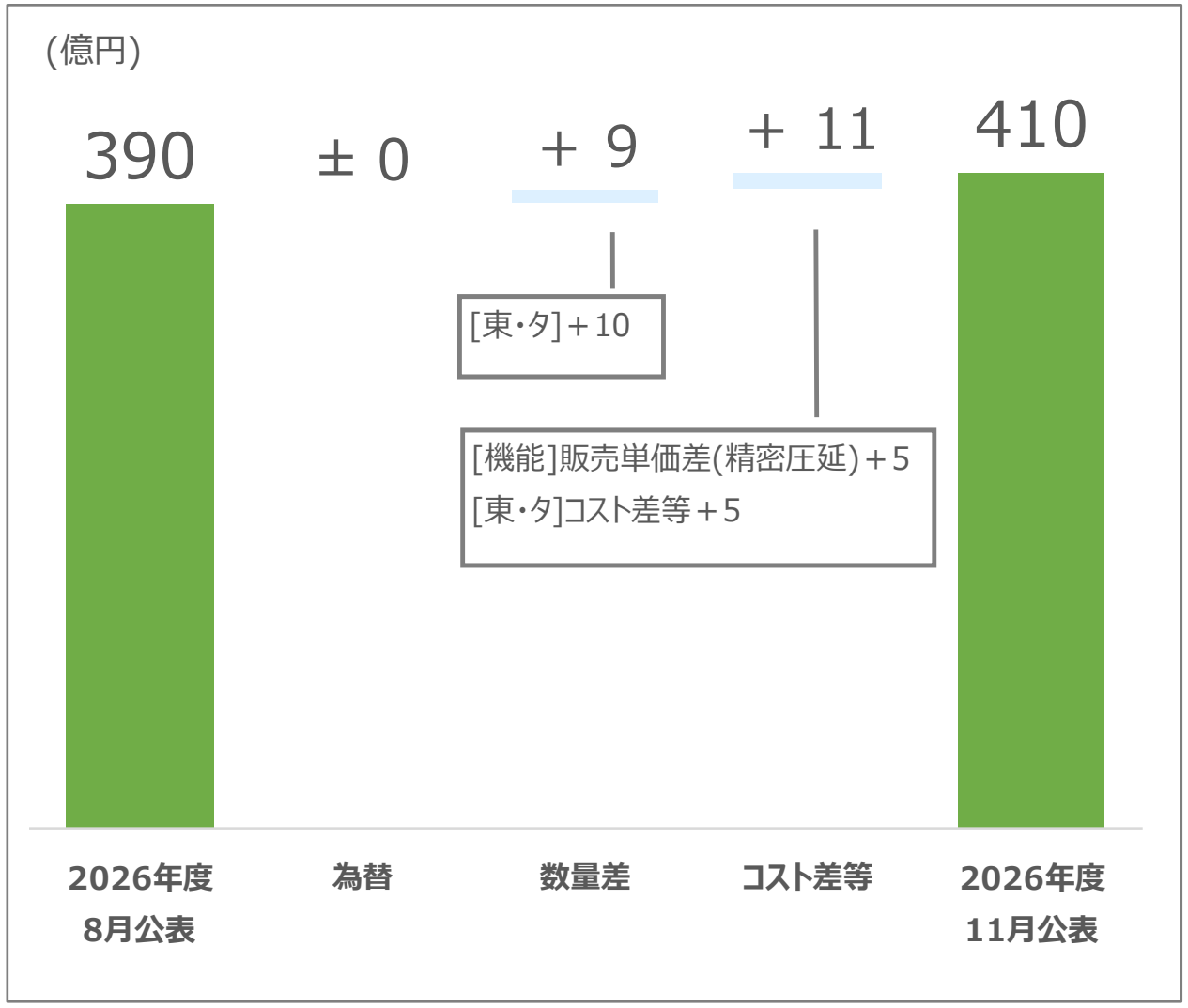
事業別 売上高・営業損益

	億円	2026年度 8月公表	2026年度 11月公表	前回比 差異	前回比 増減率
薄膜材料	売上高	1,900	2,000	＋ 100	+5%
	営業損益	580	670	＋ 90	+16%
タンタル・ニオブ(TaNb)	売上高	550	600	＋ 50	+9%
	営業損益	30	50	＋ 20	+67%
調整等	売上高	▲ 150	▲ 200	▲ 50	–
	営業損益	–	10	＋ 10	–
セグメント合計	**売上高**	**2,300**	**2,400**	**＋ 100**	**+4%**
	営業損益	**610**	**730**	**＋ 120**	**+20%**

Copyright © 2026, JX Advanced Metals Corporation, All rights reserved.

営業損益差異分析　情報通信材料セグメント[2026年度見通し 11月公表 対 8月公表]

営業損益差異分析



事業別概況

機能材料
- 精密圧延品の販売単価改善を主因に増益

東邦チタニウム、タツタ電線等
- AIデータセンター関連製品（漏水センサ）増販、コスト差等を主因に増益

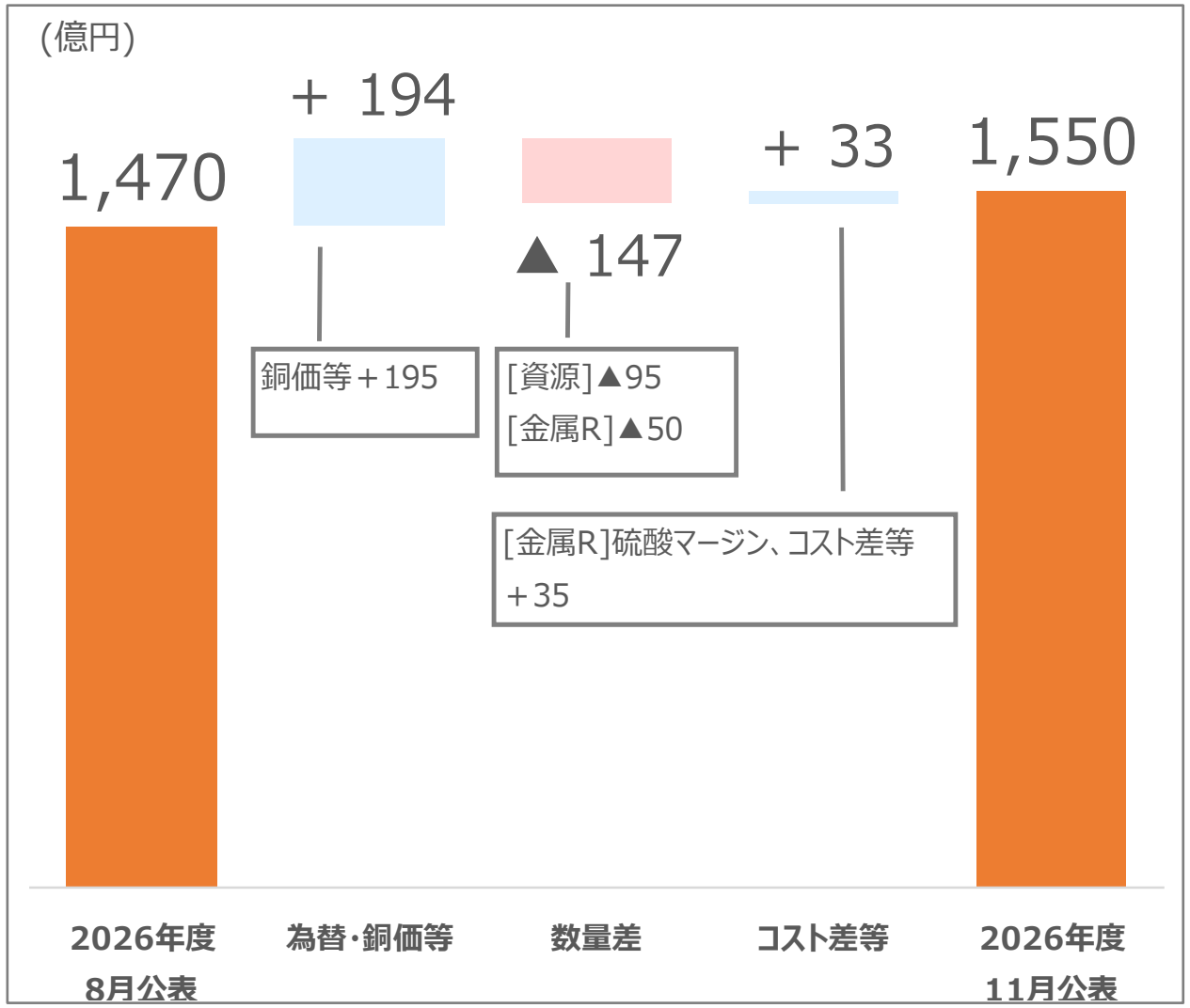
事業別 売上高･営業損益

	億円	2026年度 8月公表	2026年度 11月公表	前回比 差異	前回比 増減率
機能材料	売上高	1,800	1,900	＋ 100	+6%
	営業損益	260	260	－	－
東邦チタニウム、タツタ電線等	売上高	1,750	1,900	＋ 150	+9%
	営業損益	130	150	＋ 20	+15%
セグメント合計	**売上高**	**3,550**	**3,800**	**＋ 250**	**+7%**
	営業損益	**390**	**410**	**＋ 20**	**+5%**

Copyright © 2026, JX Advanced Metals Corporation, All rights reserved.

営業損益差異分析　基礎材料セグメント[2026年度見通し 11月公表 対 8月公表]

営業損益差異分析



事業別概況

資源

- 鉱山における減産はあるものの、銅価前提上方修正を主因に増益

金属･リサイクル（金属R）

- 減産はあるものの、硫酸マージン改善、コスト減等を主因に増益

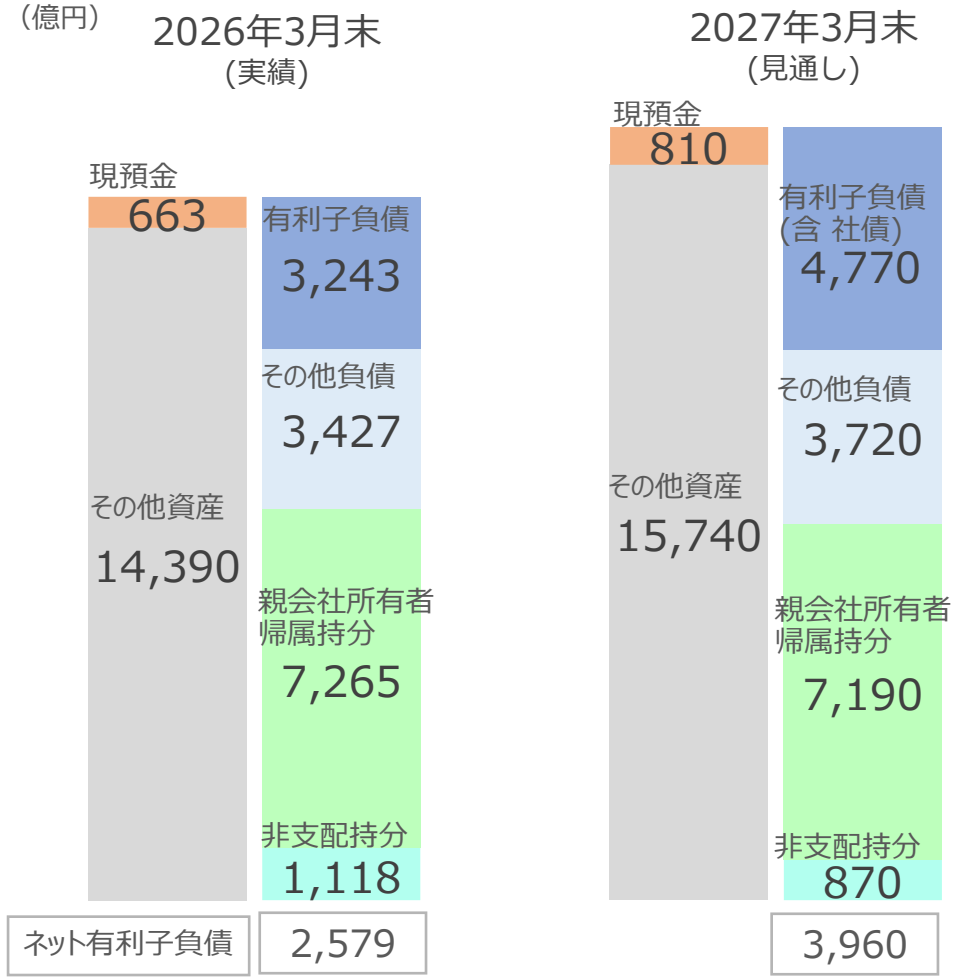
事業別 売上高･営業損益

	億円	2026年度 8月公表	2026年度 11月公表	前回比 差異	前回比 増減率
資源	売上高	50	50	－	－
	営業損益	1,180	1,250	+ 70	+6%
金属･リサイクル（金属R）	売上高	4,650	4,700	+ 50	+1%
	営業損益	290	300	+ 10	+3%
調整等	売上高	－	－	－	－
	営業損益	－	－	－	－
セグメント合計	**売上高**	**4,700**	**4,750**	**+ 50**	**+1%**
	営業損益	**1,470**	**1,550**	**+ 80**	**+5%**

Copyright © 2026, JX Advanced Metals Corporation, All rights reserved.

2026年度見通し　連結バランスシート･キャッシュフロー/株主還元

■ 連結バランスシート



主にCBの発行により有利子負債増加となる見込み。他方、自己株式の取得による自己資本の減少を通じた資本効率改善を見込む

■ 連結キャッシュフロー

（億円）

	2026年度見通し
営業キャッシュフロー	1,600
投資キャッシュフロー	▲ 950
フリーキャッシュフロー	**650**
財務キャッシュフロー	▲ 500
現金同等物の増減額	**160**
為替変動による影響等	▲ 10

■ 株主還元

配当方針（再掲）

連結配当性向25%程度を基本とした上で、配当の下限を20円/株とする。
但し、大規模な資産売却や自己株式の取得を行う場合は総還元性向も考慮して別途検討する。また、2027年3月期の株主還元方針については多額の自己株式の取得を行うため、配当は下限の20円/株とする。

	2027年3月期	
1株あたり配当金	予定	
	20円	
	中間 10円	期末 10円
配当性向	11%	

（参考：2027年3月期の総還元性向は約133%）
※自己株式取得額 1,949億円

Copyright © 2026, JX Advanced Metals Corporation, All rights reserved.

Appendix

- トピックス（2026年度）
- 会社概要
- 長期ビジョン・沿革
- 主な製品一覧
- 当社データセンター関連製品
- 半導体用ターゲットについて
- グローバルトップシェアを実現する当社半導体用ターゲットの強み
- InP基板について
- ベース事業の取り組み
- 中長期事業目標

Copyright © 2026, JX Advanced Metals Corporation, All rights reserved.

トピックス（2026年度）

前回決算発表以降のリリース　半導体材料　情報通信材料　基礎材料

- 5月　銅精鉱の購入・電気銅等の販売に係る事業の統合に関する最終契約書の締結
- 6月　台湾日鉱金属における半導体用スパッタリングターゲット加工ラインの自動化投資の決定
- 6月　TANIOBIS社タイ国内生産拠点での機能性タンタル粉末の生産能力増強
- 6月　ハードディスクメディア向け磁性材スパッタリングターゲット生産能力増強
- 6月　インジウムリン(InP)基板の大幅な生産能力増強に向けた設備投資方針の決定
- 6月　半導体検査プローブカード向け材料(ロジウムめっき液)の生産能力増強の決定
- 7月　韓国ＪＸ金属における半導体用スパッタリングターゲットの加工能力増強の決定
- 8月　AIデータセンター内で使用される漏水検知システムの生産能力増強 (タツタ電線)
- **9月　AIデータセンター向けMLCC用超微粉ニッケルの生産能力増強 (東邦チタニウム)**
- **9月　ハードディスクメディア向け磁性材スパッタリングターゲットの更なる生産能力増強**
- **9月　Tronox 社とレアアース製錬事業への新規参入に向けた共同スタディの合意**
- **10月　AIデータセンター内で使用される漏水検知システムの更なる生産能力増強 (タツタ電線)**
- **10月　国内資源循環の高度化を目指したJX金属サーキュラーソリューションズとリネットジャパングループの資本業務提携**
- **10月　AI関連需要の拡大に伴うチタン銅の生産能力増強**
- **11月　先端半導体市場向けの高純度硫酸銅「ユピノーグ」の生産能力増強**
- **11月　フォトニクス分野のリーディングカンパニーであるオキサイド社との資本業務提携契約**

Copyright © 2026, JX Advanced Metals Corporation, All rights reserved.

会社概要

半導体・情報通信分野に欠かせない先端素材をマーケットに供給するグローバルトップメーカー

グローバルシェア

フォーカス事業

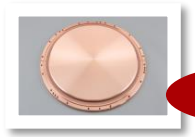
高度な技術的差別化の実現により、グローバル競争優位性を持つ当社成長戦略のコア事業

☆ AIサーバ関連

半導体材料

薄膜材料

半導体用ターゲット☆



約65%[1]

半導体ウエハにナノレベルの膜を形成するために必要な金属材料

磁性材ターゲット☆



約60%[1]

大容量ハードディスクドライブに膜を形成するために必要な金属材料

インジウムリン InP基板☆



約40%[1]

光通信用の受発光素子材料

カドミウム・ジンク・テルル CdZnTe基板



放射線・赤外線センサ素子に使用される単結晶基板

CVD[4]/ALD[5]プリカーサ材料☆



CVD/ALDによる薄膜形成に使用される金属原料

情報通信材料

機能材料

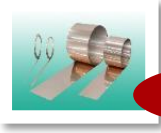
圧延銅箔



78%[2]

FPC[3]に用いられる屈曲性に優れた金属箔

チタン銅☆



約70%[1]

強度・導電性・曲げ加工性に優れた合金材料

タンタル・ニオブ

タンタル粉末☆



約50%[1]

半導体用ターゲットやキャパシタに使用される金属粉末

東邦チタニウム

MLCC用 超微粉Ni☆



MLCCの内部電極に使用される高純度金属粉末

タツタ電線

漏水センサ☆



主にAIサーバーでの水冷設備向けの漏水検知センサ

最終用途例

- AIサーバ
- ウェアラブル
- スマートフォン
- モビリティ（xEV/ADAS）

ベース事業

銅、レアメタル（タンタル、チタンなど）のサプライチェーン強化を通じて、フォーカス事業の成長を支える

注1: 当社推定; 注2: 富士キメラ総研「2024 エレクトロニクス実装ニューマテリアル便覧」(2023年実績、FPC向けのみ、出荷数量ベース); 注3: Flexible Printed Circuits (フレキシブルプリント基板) と呼ばれる、絶縁性を持ったベースフィルムと銅箔等の導電性金属を貼り合わせた基材に電気回路を形成した基板; 注4: Chemical Vapor Deposition; 注5: Atomic Layer Deposition

Copyright © 2026, JX Advanced Metals Corporation, All rights reserved.

長期ビジョン・沿革

● 長期ビジョン**策定**

● 基本方針

「装置産業型企業」から「技術立脚型企業」への転身により、
激化する国際競争の中にあっても高収益体質を実現、
半導体材料／情報通信材料のグローバルリーダーとして、
持続可能な社会の実現に貢献する

● 目指すポートフォリオ

【成長】フォーカス事業

- 成長戦略のコアとして位置づけ
- 技術による差別化によりグローバル競争で優位に立ち、市場成長以上の利益成長を図る

【基盤】ベース事業

- サプライチェーン強化を通じてフォーカス事業の成長を支える
- 半導体材料/情報通信材料に不可欠な銅及びレアメタルを中心ドメインと位置付ける

事業沿革

会社沿革

1905 日立鉱山**開業（ＪＸ金属グループの創業）**
日立製作所や日産自動車などを傘下に置いた日産コンツェルンの源流

1916 **金属製錬事業**拡張
佐賀関製錬所操業開始

1929 日本鉱業**設立**



1964 **金属加工事業**本格進出
倉見工場開設

1978 **リサイクル事業**開始
日立事業所
リサイクル炉新設

1985 **電子材料事業**本格進出
磯原工場開設

2002 新日鉱HD**設立**
ジャパンエナジーと日鉱金属が共同持株会社
新日鉱HD (現ＪＸ金属株式会社) を設立

2010 ＪＸ日鉱日石金属に**改称**
新日本石油と新日鉱HDによる
JXHD (現ENEOS HD) 設立に伴い改称

2016 **レアメタル事業**強化
H.C. Starck Tantalum & Niobium
(現TANIOBIS GmbH)株式取得

2018 ＪＸ金属に**改称** JX金属株式会社

2019

2023 長期ビジョン**改定**

2024 英文商号の**変更**
英文商号を
「JX Advanced Metals Corporation」へ変更

Copyright © 2026, JX Advanced Metals Corporation, All rights reserved.

主な製品一覧

主な製品（写真）

半導体材料


半導体用ターゲット


磁性材ターゲット


InP基板

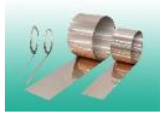

CdZnTe基板


CVD・ALD材料


タンタル粉

情報通信材料


圧延銅箔

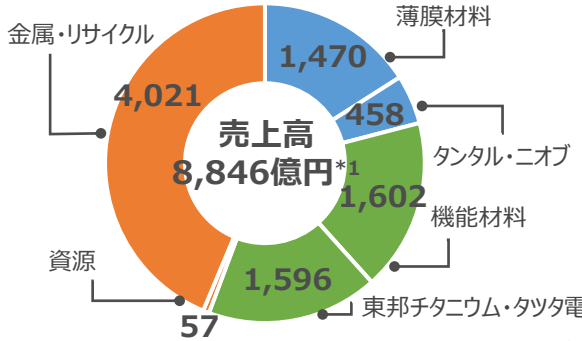

チタン銅

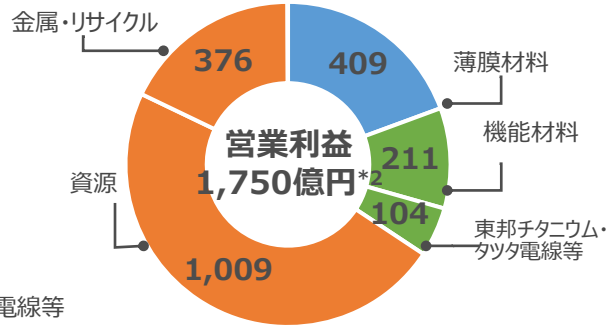
基礎材料


銅精鉱（銅鉱山）


電気銅

サブセグメント別 売上高/営業損益（2025年度）





*1;内部取引消去▲358億円を含む　2;事業共通費等▲352億円、タンタル・ニオブ営業損益▲7億円を含む

(2026年8月時点)

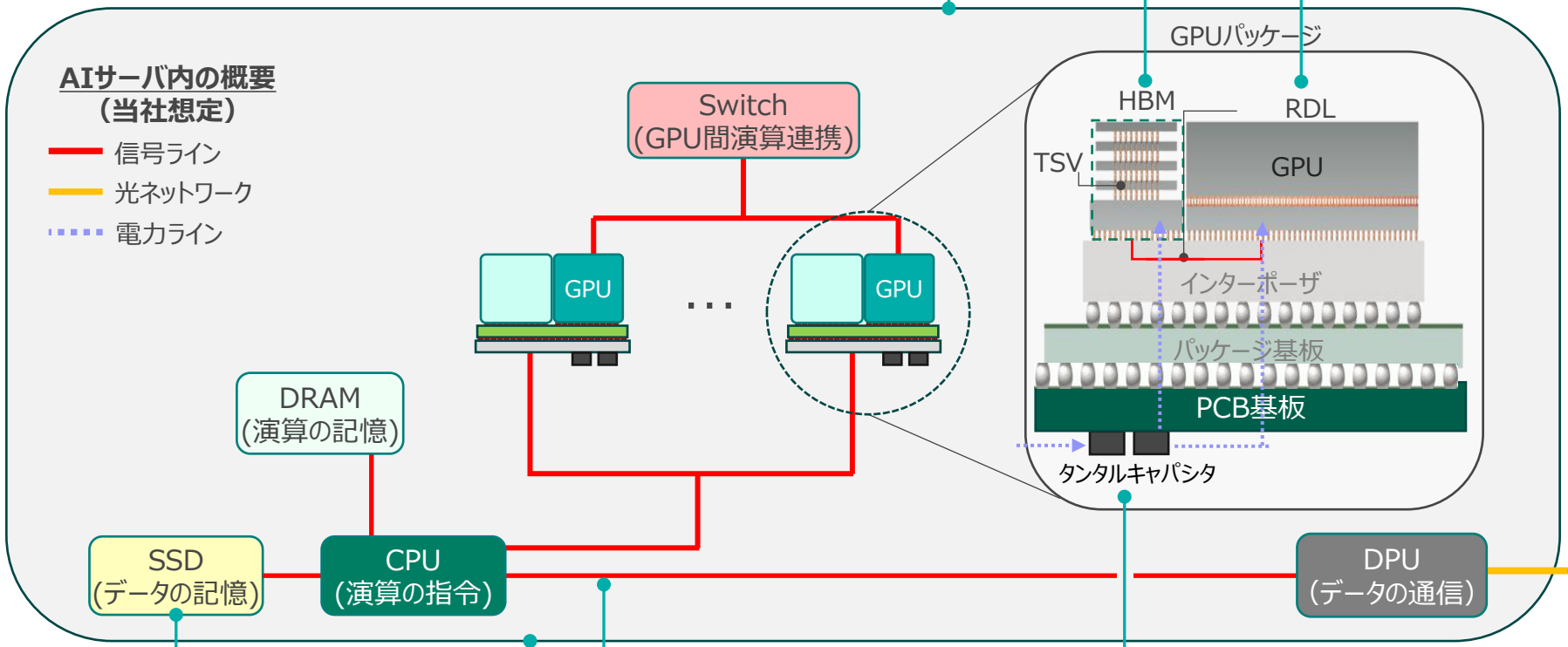
	セグメント	サブセグメント		主な製品	主要用途	最終用途例
フォーカス事業	半導体材料	薄膜(はくまく)材料		半導体用ターゲット	半導体ウエハ上の金属薄膜形成	半導体（データセンター、PC、スマートフォン）
				磁性材ターゲット	磁気記録メディア上の金属薄膜形成	HDD（データセンター）、磁気センサ
				インジウムリン（InP）基板	光⇔電気の変換（受発光素子）	光通信（データセンター）
				カドミウム・ジンク・テルル（CdZnTe）基板	赤外線検知、放射線検知	防衛システム、CTスキャン
				CVD・ALD用材料	半導体用配線材料	半導体（データセンター、PC、スマートフォン）
		タンタル・ニオブ		スパッタリングターゲット向けタンタル粉末	半導体用ターゲット向け材料	半導体（データセンター、PC、スマートフォン）
				キャパシタ向けタンタル粉末	タンタルキャパシタ向け材料	タンタルキャパシタ（データセンター、PC）
	情報通信材料	機能材料		圧延銅箔	FPC（フレキシブルプリント基板）用材料	スマートフォン、ウェアラブル、ロボット、医療用カテーテル
				チタン銅	コネクタ用材料、カメラばね用材料	サーバ向けコネクタ（データセンター）、カメラモジュール
		東邦チタニウム・タツタ電線	(東邦チタ)	スポンジチタン	航空機エンジン部品、機体材料	航空機、化学・電力プラント
				化学品（超微粉ニッケル）	積層セラミックコンデンサ（MLCC）内部電極向け材料	積層セラミックコンデンサ
				THC触媒	ポリプロピレン、ポリオレフィン製造用触媒	自動車内外装、家電製品、包装材
			(タツタ)	インフラ・産業機器用電線	電線向け材料	発電所・プラント向け電線・ケーブル
				電磁波シールドフィルム	電子モバイル機器の内部回路保護	スマートフォン
ベース事業	基礎材料	資源		銅精鉱・電気銅・モリブデン精鉱	-	-
				（持分比率）カセロネス銅鉱山：25%　ロス・ペランブレス銅鉱山：12.52%　エスコンディーダ銅鉱山：3%		
		金属・リサイクル		電気銅、型銅、貴金属、硫酸	-	-
				（持分比率）パンパシフィック・カッパー：47.8%		

Copyright © 2026, JX Advanced Metals Corporation, All rights reserved.

当社データセンター関連製品

半導体材料　機能材料　グローバルシェア

AIサーバ内の概要
（当社想定）
- 信号ライン
- 光ネットワーク
- 電力ライン





CVD/ALD
プリカーサ材料



約70%*1

チタン銅



約50%*2

タンタル粉末



約40%*1

InP基板



約60%*1

磁性材ターゲット

半導体用ターゲット



約65%*1

漏水センサ(タッタ電線)



*1：当社推定　*2：当社推定。スパッタリングターゲット向け含む

Copyright © 2026, JX Advanced Metals Corporation, All rights reserved.

半導体用ターゲットについて

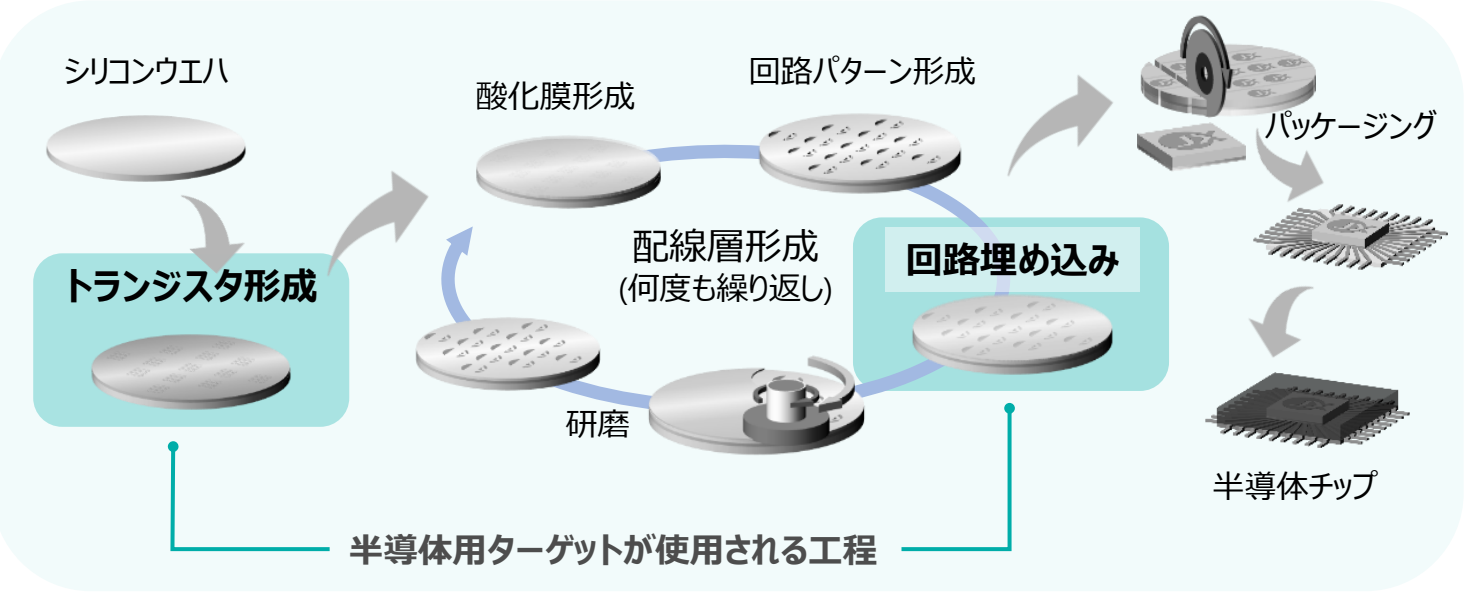
半導体用ターゲットとは



No.1
世界シェア
約6割

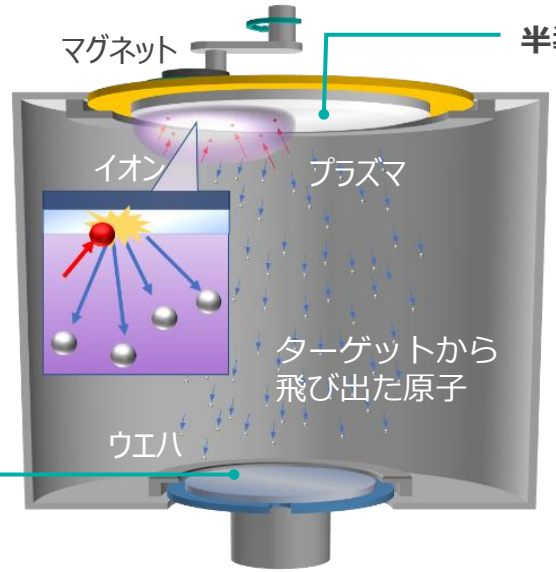
シリコンウエハ上にトランジスタや配線層を形成するためのPVD*1工程で必要となる高純度の金属材料

半導体チップ製造における使用工程

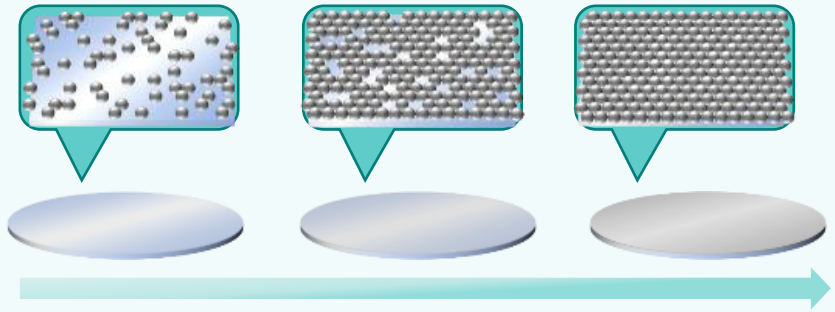


使用過程・構造

（スパッタチャンバー内部模式図）



スパッタリングプロセスで膜が形成される様子(模式図)



*1 Physical Vapor Deposition (物理気相成長法) の略。金属材料を気化させて基板に成膜する方法。スパッタリング法は代表的なPVDプロセスのひとつ

Copyright © 2026, JX Advanced Metals Corporation, All rights reserved.

グローバルトップシェアを実現する当社半導体用ターゲットの強み

技術力の高さやメーカー・顧客との関係性、グローバルな生産体制を完備し、グローバルトップシェアを実現

世界トップクラスの技術力

高純度化、組成・組織制御、表面処理、分析評価などで高い技術力を保有



世界最高レベルの高純度銅
純度
99.9999999%

半導体製造装置メーカーとの強固な関係

装置メーカーとの関係構築を通じて装置の標準材料への指定を獲得

ＪＸ金属　　装置メーカー

顧客(半導体メーカー)との信頼関係

長年にわたる取引実績を有し優秀なサプライヤーとして表彰獲得



TSMC



Intel



SK hynix

グローバルな生産体制

半導体メーカーの生産拠点との地理的優位性のある拠点を保有



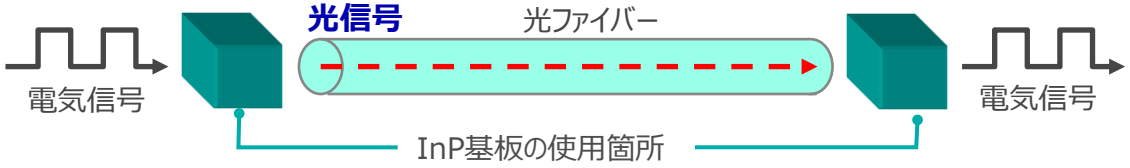
Copyright © 2026, JX Advanced Metals Corporation, All rights reserved.

InP基板について

- 光通信用途で使用されるインジウムリン（InP）基板は、**データセンター向けで販売好調**
- 急速な市場の拡大を捕捉すべく、**更なる増産に向けた設備投資を決定**
- 今後**データセンター内通信の光化の進展に伴い、更なる成長ポテンシャル**も期待

InP基板とは

- 電気信号と光信号の変換を行う光通信用途として、データセンター・インターネット網に使用される材料
- InPは光トランシーバーの受光素子・発光素子に使用される

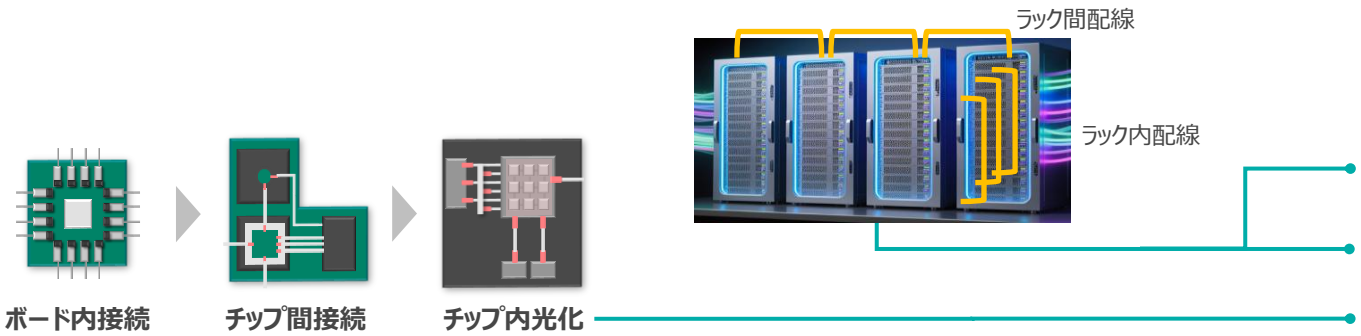


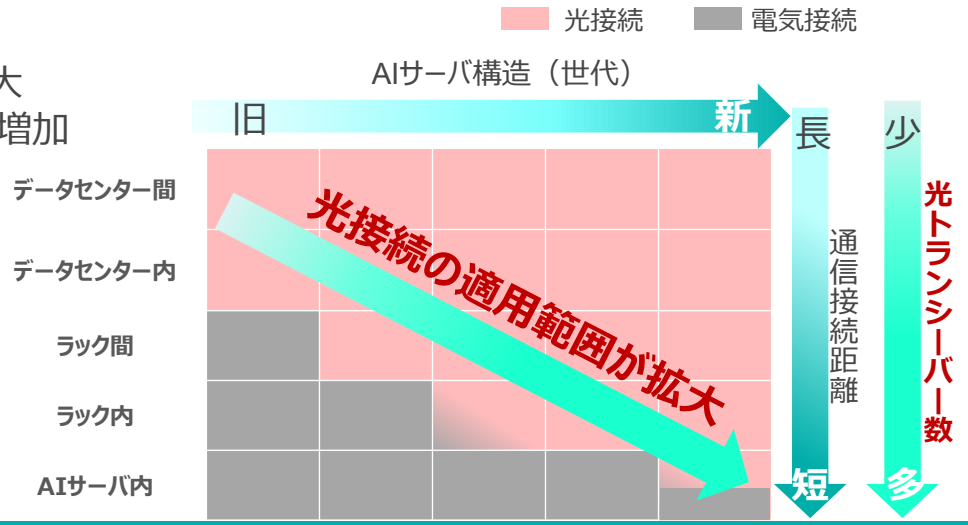
InP収益規模拡大に向けた取り組み

リリース	生産能力 - 2025年度比	投資額
2025年7月	２割増	約15億円
2025年10月	約５割増	約33億円
2026年2月	約３倍（27年度以降順次稼働予定）	約200億円
2026年6月	7~10倍	最大 1,200億円

電気から光へのシフトに伴う成長機会

- 高速通信化・データセンター内の消費電力増加に伴い、近距離向けにも光通信の適用が拡大
- 光通信の適用範囲拡大に伴いトランシーバー使用量が増えることで、当社InP基板の需要も増加





Copyright © 2026, JX Advanced Metals Corporation, All rights reserved.

ベース事業の取り組み

長期ビジョンに沿ったフォーカス事業中心のポートフォリオに向けて、ベース事業の最適な体制を構築

ベース事業における主な取り組み：事業規模の適正化、フォーカス事業のサプライチェーン確保を着実に実行

	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度
資源事業 ベースメタルからレアメタルへ	Mibra鉱山(タンタル)投資	カセロネス銅鉱山およびロス・ペランブレス銅鉱山権益の一部売却	カセロネス銅鉱山権益の追加売却	Copi PJ(レアメタル・レアアース)参入・丸紅の開発調査への参加 カセロネス銅鉱山の一部権益・フロンテラ地域における銅鉱山開発プロジェクト権益譲渡 Fireweed社(レアメタル等)株式取得 （2026年4月クロージング）	レアアース製錬事業への新規参入に向けた、Tronox社との共同スタディ
金属・リサイクル事業 リサイクル中心のより効率的な体制へ	韓国の銅製錬JVのLS-Nikko全持分売却 eCycleの株式取得（双日との協業）	パンパシフィック・カッパー株式の一部譲渡	製錬・リサイクル事業の高付加価値化（三菱商事との協業）	パンパシフィック・カッパー(JX金属・三井金属・丸紅)と三菱マテリアルの銅精鉱の購入・電気銅等の販売に係る事業の統合 ➢ 最終契約書締結 (2026年5月) 出資比率：JX金属32.50%、三菱マテリアル32.00%、三井金属21.90%、丸紅13.60%	国内資源循環の高度化を目指した、JX金属サーキュラーソリューションズとリネットジャパングループの資本業務提携

Copyright © 2026, JX Advanced Metals Corporation, All rights reserved.

中長期事業目標

✓ 目標達成に向け、着実に進捗中

		2023年度 実績	2024年度 実績	2025年度 実績	2026年度 見通し	(参考) CAGR (2023年度-2026年度)	2027年度 目標
営業利益	[連結]	862 億円	1,125 億円	1,750 億円	2,550 億円	(44%)	CAGR10%~15% (2023年度-2027年度)
	(YoY成長率)		30.5%	55.6%	45.7%		
	[フォーカス事業]	273 億円	518 億円	710 億円	1,140 億円	(61%)	CAGR35%~40% (2023年度-2027年度)
	(YoY成長率)		89.7%	37.1%	60.6%		
営業利益率	[連結]	5.7%	15.7%	19.8%	24.3%		12%~17%
	[フォーカス事業]	8.8%	12.5%	14.3%	18.4%		15%~20%
	[半導体材料セグメント]	21.4%	18.0%	22.3%	30.4%		25%~30%
	[情報通信材料セグメント]	0.5%	9.5%	9.9%	10.8%		8%~13%
営業利益構成比率	[フォーカス事業]	26%	41%	34%	42%		67%以上
	[半導体材料セグメント]	25%	21%	19%	27%		45%以上
ROE		18.3%	11.0%	15.6%	22.2%		10%以上
NET Debt/EBITDA倍率		2.6倍	1.6倍	1.2倍	1.3倍		1.5倍未満

Copyright © 2026, JX Advanced Metals Corporation, All rights reserved.

注意事項

本資料に記載されている当社の目標、計画、見積もり、予測、予想、ターゲットその他の将来情報については、本資料の作成時点において、当社が入手できる情報をもとに、一定の前提に基づく当社の判断又は考えに過ぎず、実際の当社の経営成績、財政状態その他の結果は、国内外の経済情勢・市場環境、事業活動、他社との競争環境その他様々な要因等により、本資料の内容又は本資料から推測される内容と大きく異なることがあります。

Copyright © 2026, JX Advanced Metals Corporation, All rights reserved.

JX金属株式会社